

diasom.ru



КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ

Отечественные процессорные модули
и модули камер

О КОМПАНИИ	03
DS-RK3568	04
DS-RK3568-EVB	05
DS-RK3568-SMARC	06
DS-RK3568-SODIMM	07
DS-RK3588-BTB	08
DS-RK3588-BTB-EVB	09
DS-RK3588-SMARC	10
DS-IMX8M	11
DS-IMX8M-EVB	12
DS-Z7100-BTB	13
DS-SMARC21-EVB.....	14
DS-SMARC-CARRIER	15
МОДУЛИ ЭЛЕКТРОННЫЕ КАМЕР	16
КОНТРАКТНАЯ РАЗРАБОТКА	19



DIASOM — это российская разработка и производство процессорных модулей (System-on-Module, SOM)

Идея собственных разработок появилась в феврале 2020 года — тогда мы поняли, что можем создавать продукты не хуже зарубежных.

Начали с модуля на i.MX8M mini, затем перешли на RK3568 и в сентябре 2023 года выпустили первые серийные образцы.

Модули DIASOM производятся на нашем заводе в Санкт-Петербурге, который оснащён высокотехнологичным оборудованием (SMT, THT-линии, монтаж до 01005), 100% автоматизированным контролем (3D SPI, 3D AOI), выборочной рентген-проверкой пайки BGA и 100 % выходным функциональным тестированием.

Внедрены стандарты IPC-A-610 Class 2/3 и MES-система для прослеживаемости, а строгие меры ESD-безопасности защищают компоненты на всех этапах.

Если требуется, то наносим влагозащиту, изготавливаем корпуса, проводим климатические и иные испытания, а модули и отладочные платы отгружаем в ESD-упаковке.

Наше производство также обеспечивает сборку конечных устройств на базе SOM, гарантируя надёжность и длительный срок службы.

ЧТО ЗНАЧИТ DIASOM?

Design → Разработка

Integration → Интеграция

Assembly → Производство

SOM → of System-on-Module

НАША ЦЕЛЬ НА СЛЕДУЮЩИЕ 5 ЛЕТ:

Популяризация SOM-технологий в России и дружественных странах. Мы стремимся стать лидерами в сфере надёжных систем, предлагая не только модули, но и поддержку на всех этапах — от проектирования до интеграции.

НАША ПРИНЦИПЫ:



УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ И МОДУЛЬНОСТЬ

Модули легко адаптируются под любые задачи — от автоматизации до беспилотного транспорта.



ОТКРЫТОСТЬ В РАБОТЕ

Готовы показывать производство и стремимся предлагать интересные рынку продукты.



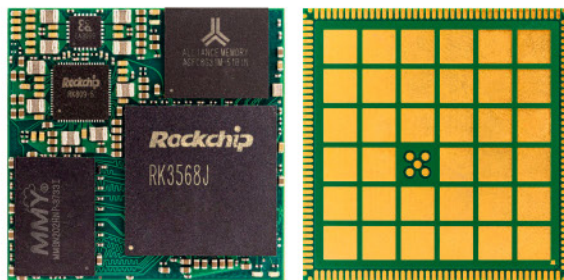
СОБСТВЕННОЕ ЛОКАЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВО

Полный цикл: от идеи до сборки — в России.



DS-RK3568 — сверхкомпактный (35 × 35 мм) промышленный SOM на базе 4х ядерного ARM.

Является эффективной альтернативой модулям на i.MX6/8, подходит для многозадачных и мультимедийных применений.



Эффективный теплоотвод



Экономия времени на разработку



Легко интегрировать в текущий дизайн



Вибростойкое соединение

100%

Выходной контроль



Короткий срок поставки

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ DS-RK3568:

ПАРАМЕТР	ЗНАЧЕНИЕ	
Процессорные ядра	4 × Cortex®-A55 64 бит до 2 ГГц	
ОЗУ (LPDDR4 32-бит)	512 МБ / 2 / 4 / 8 ГБ	
Flash (eMMC)	8 / 32 / 128 ГБ	
Мультимедиа	- Аппаратный кодек 1080p60 H.265/H.264 - Декодер 4K60 H.265/H.264	
Графический процессор	ARM G52-2EE с поддержкой OpenGL ES 3.2, OpenCL 2.0	
Нейроускоритель	До 1 TOPs, поддержка: TensorFlow, TFlite, Pytorch, Caffe, ONNX, MXNet, Keras, Darknet	
Операционные системы	Linux BSP, Buildroot+QT5, BootLoader – U-Boot, Нейтрино (СВД ВС), Ubuntu, Debian, Ред ОС, ОС «Альт»	
Питание	3,6...5 В DC, до 5 Вт	
Диапазон температур	-40...+85 °C	
Интерфейсы	- PCIe 3.0 ×2 - SATA 3.0 / PCIe 2.1 - 2 × Gigabit Ethernet (RGMII) - USB 3.0 OTG - USB 3.0 Host - HDMI 2.0 - JTAG - 4 × UART, 2 × I²S, 2 × SPI, 2 × CAN - MIPI DSI (4 линии) / LVDS - MIPI CSI-2 (4 линии) - GPIO (1,8 В) - SDIO 3.0	

* Список интерфейсов приведён в рамках реализации в отладочном комплекте DS-RK3568-EVB. Назначение пинов может быть изменено через Device Tree согласно документации.

СОСТАВ ОТЛАДОЧНОГО КОМПЛЕКТА:

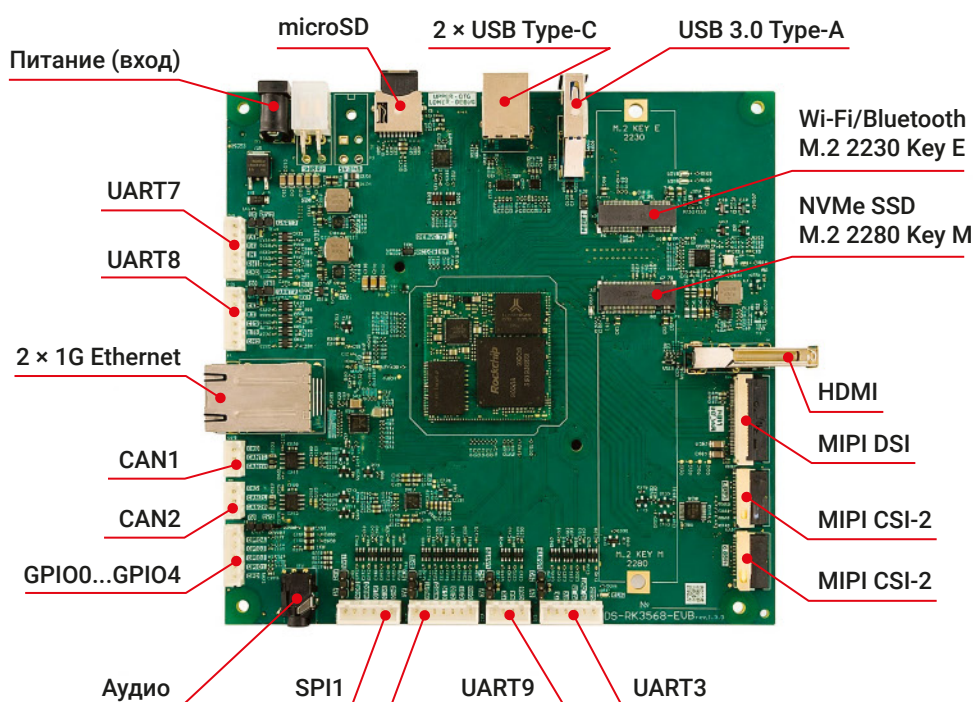
1. ОСНОВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ:

- Модуль DS-RK3568 (запаян в плату)*
- Микро SD-карта объёмом не менее 8 ГБ
- Кабель для подключения лабораторного источника питания 12 В DC, 1 А
- Комплект опор для настольной установки
- Комплект проводов для низкоскоростных интерфейсов

2. РЕКОМЕНДОВАННЫЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ:

- Дисплей 10,1" (1024 × 768) с входом MIPI DSI (в комплекте: шлейфы и переходник для подключения к плате)
- Модуль видеокamеры DS-CIMX и дополнительно переходник для подключения с необходимыми шлейфами
- Wi-Fi/Bluetooth-адаптер M.2 2230 Key E
- NVMe SSD M.2 2280 Key M

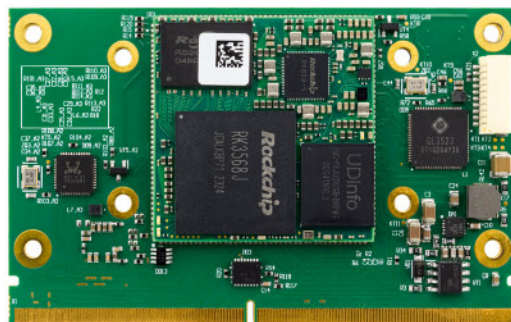
* Для программирования или проведения входного тестирования SOM возможна поставка отладочной платы DS-RK3568-EVB с установленным сокетом вместо запаянного SOM



Для удобства работы с отладочным комплектом доступны репозитории со скриптами и исходниками для сборки тестового образа

DS-RK3568-SMARC — процессорный модуль стандарта SMARC 2.1, созданный для замены дорогих или дефицитных решений на базе x86 и премиальных ARM-платформ.

Модуль реализован в виде базовой платы-адаптера с установленным процессорным модулем DS-RK3568, благодаря чему удалось удешевить решение и при этом обеспечить соответствие стандарту SMARC 2.1.



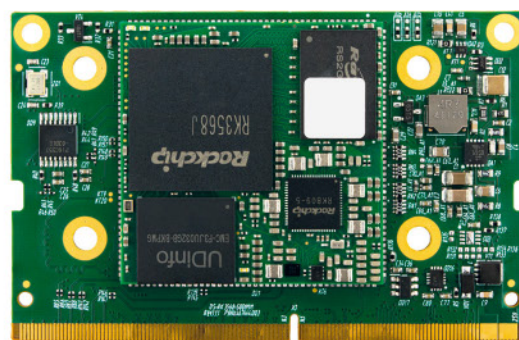
Идеально подходит для промышленной автоматизации, медицинского оборудования, умного ритейла и везде, где требуется легкий ремонт конечных изделий.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ DS-RK3568-SMARC:

ПАРАМЕТР	ЗНАЧЕНИЕ
Процессорные ядра	SOM DS-RK3568 на базе ARM процессора 4 × Cortex®-A55 64 бит до 2 ГГц
ОЗУ (LPDDR4 32-бит)	2 / 4 / 8 ГБ
Flash (eMMC)	32 ГБ
EEPROM	2 × 64 Кбайт с фиксированным MAC
Операционные системы	Linux BSP, Buildroot+QT5, BootLoader – U-Boot, Нейтрино (СВД ВС), Ubuntu, Debian, Ред ОС, ОС «Альт»
Питание	5 В DC до 5 Вт
Часы реального времени (RTC)	Встроенные, с поддержкой резервного питания
Диапазон температур	-40...+85 °C
Габаритные размеры	82 × 50 мм
Интерфейсы * Назначение пинов может быть изменено через Device Tree согласно документации	- MIPI CSI-2 (4 линии) - MIPI DSI (4 линии) - 2 × SPI, 4 × UART, SDIO, I²C, 2 × CAN, GPIO - 4 × USB 3.0 (один порт поддерживает OTG) - HDMI - PCIe 2.0 и PCIe 3.0 - SATA (1 порт) - Аудио (I²S)

DS-RK3568-SODIMM — выполнен в хорошо известном и ставшем на рынке стандартом форм-факторе SODIMM (Nvidia Jetson TX2), который легко устанавливается и заменяется, что упрощает обслуживание и апгрейд системы.

Данный SOM спроектирован как переходная плата с распаянным на ней модулем DS-RK3568, что позволяет обеспечить лучшее отведение тепла и его более равномерное распределение.



DS-RK3568-SODIMM легко интегрируется и идеален для встроенных и роботизированных систем, видеонаблюдения и промышленной автоматики.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ DS-RK3568-SODIMM:

ПАРАМЕТР	ЗНАЧЕНИЕ
Процессорные ядра	SOM DS-RK3568 на базе ARM процессора 4 × Cortex®-A55 64 бит до 2 ГГц
ОЗУ (LPDDR4 32-бит)	2 / 4 / 8 ГБ
Flash (eMMC)	32 ГБ
EEPROM	2 × 64 Кбайт с фиксированным MAC
Операционные системы	Linux BSP, Buildroot+QT5, BootLoader – U-Boot, Нейтрино (СВД ВС), Ubuntu, Debian, Ред ОС, ОС «Альт»
Питание	5 В DC до 5 Вт
Часы реального времени (RTC)	Встроенные, с поддержкой резервного питания
Диапазон температур	-40...+85 °C
Габаритные размеры	69,6 × 45 мм
Интерфейсы * Назначение пинов может быть изменено через Device Tree согласно документации	- MIPI CSI-2 (4 линии) - MIPI DSI (4 линии) - 2 × SPI, 3 × UART, SDMMC, 2 × I²C, CAN, GPIO - 4 × USB 3.1 (один порт с поддержкой OTG) - 2 × Gigabit Ethernet (PHY с поддержкой PTP) - HDMI (1080p60) - PCIe 2.0 и PCIe 3.0 - Аудио (I²S)

DS-RK3588-BTB — высокопроизводительный SOM на базе флагманского RK3588J со встроенным NPU на 6 TOPS. Компактный форм-фактор с двумя 200-пиновыми межплатными разъёмами обеспечивает вывод максимума интерфейсов на базовую плату, предлагая баланс между вычислительной мощностью, надёжностью и минимальными габаритами.

Оптимален для решения сложных задач в сфере промавтоматизации, машинного зрения, транспортного оборудования, энергетики и специальных телекоммуникационных систем.



ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ DS-RK3588-BTB:

ПАРАМЕТР	ЗНАЧЕНИЕ	
Процессорные ядра	4 × Cortex-A76 до 2,4 ГГц, 4 × Cortex-A55 до 1,8 ГГц	
ОЗУ (LPDDR4)	2 × 2 / 2 × 4 / 2 × 8 ГБ	
ПЗУ (eMMC)	32 / 128 ГБ (только для версии с ОЗУ на 16 ГБ)	
EEPROM	2 × 64 Кбайт с фиксированным MAC	
Графический процессор	Mali-G610 MP4 с поддержкой OpenGL ES 3.2, OpenCL 2.2	
Мультимедиа	Аппаратные кодеки H.265/H.264	
Нейроускоритель	До 6 TOPs, с поддержкой TensorFlow Lite, Caffe и др.	
Операционные системы	Linux BSP, Buildroot, Ubuntu, Ред ОС	
Питание	12 В DC (5 - 23 Вт в рабочем режиме)	
Часы реального времени (RTC)	Встроенные, с поддержкой резервного питания	
Диапазон температур	-40...+85 °C	
Габаритные размеры	65 × 45 × 10 мм	
Интерфейсы	* Список интерфейсов приведён в рамках реализации в отладочном комплекте S-RK3588-BTB-EVB. Назначение пинов может быть изменено через Device Tree согласно документации. - 2 × MIPI CSI-2 (4 линии) - 2 × MIPI DSI (4 линии) - HDMI TX / RX - 2 × Gigabit Ethernet (RGMII) - PCIe 3.0 x4, PCIe 2.1 x2 - 2 × USB 3.0 OTG - 2 × USB 2.0 Host - 3 × CAN, 10 × UART, 2 × SATA 3.0 - 9 × I²C, 4 × SPI, 4 × I²S - PDM / Audio PWM - 2 × LVDS через конвертер - GPIO (1,8 / 3,3 В) - SDIO 3.0 - S/PDIF	

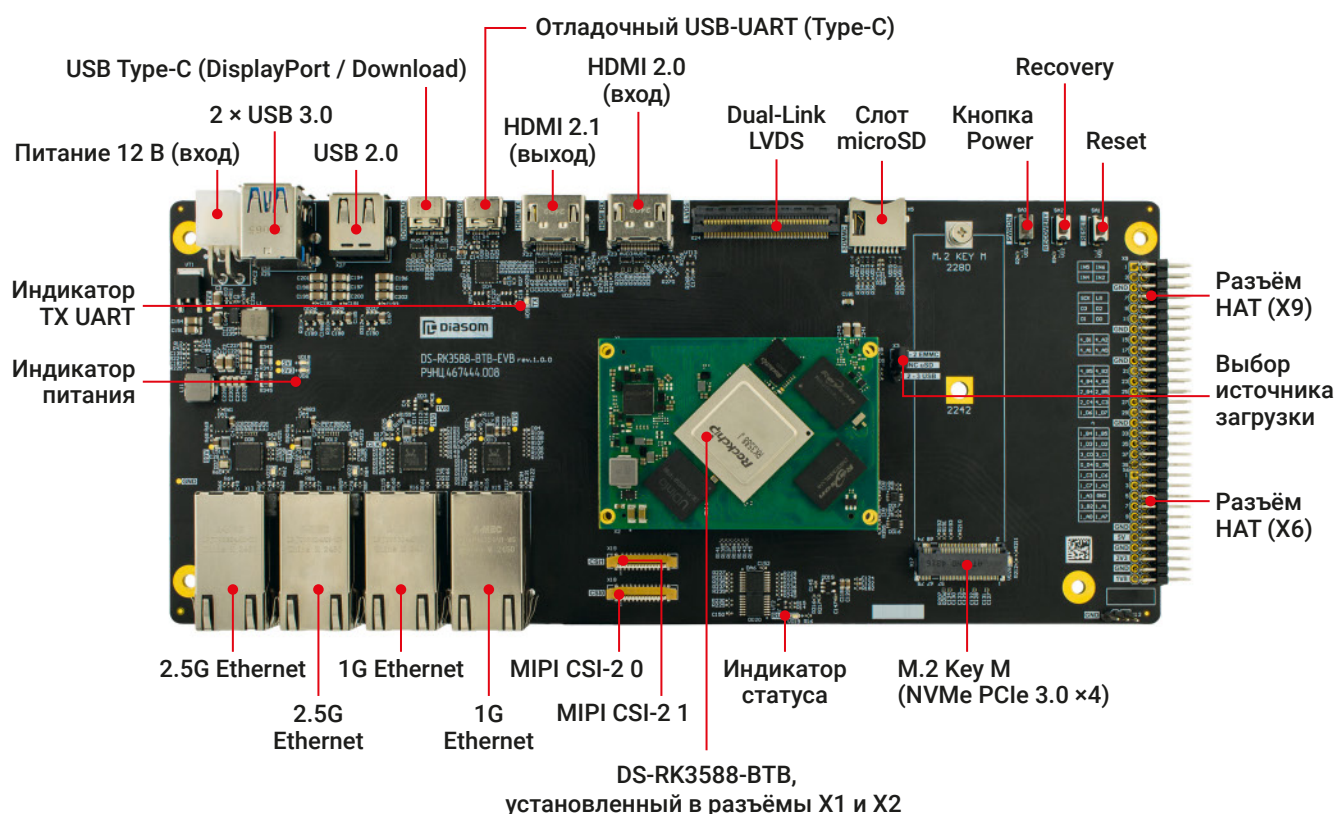
СОСТАВ ОТЛАДОЧНОГО КОМПЛЕКТА:

1. ОСНОВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ:

- Модуль DS-RK3588-BTB-D16-E32 (набор памяти может быть изменён без уведомления)
- Плата расширения DS-RK3588-BTB-EVB-HAT с выведенными интерфейсами:
Аудио (3,5 мм), 2 × CAN, 2 × RS-485, SPI, 2 × I²C, 7 × GPIO, 4 × PWM, UART, 4 × ADC
- Микро SD-карта объёмом не менее 8 ГБ
- Кабель для подключения лабораторного источника питания 12 В DC, 3 А (макс. 45 Вт)
- Комплект опор для настольной установки
- Экстрактор для извлечения модуля
- Радиатор DS-RK3588-BTB-HS с креплениями

2. РЕКОМЕНДОВАННЫЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ:

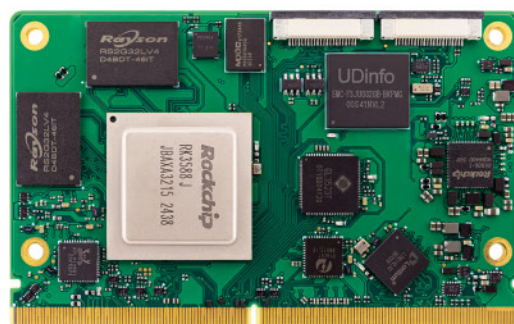
- Дисплей 10,25" (1920×720, Dual-Link LVDS)
в комплекте с переходником и шлейфом для подключения
- Модуль видекамеры DS-CIMX
- Wi-Fi/Bluetooth M.2 2230 Key E
- NVMe SSD M.2 2280 Key M



Для удобства работы с отладочным комплектом доступны репозитории со скриптами и исходниками для сборки тестового образа

DS-RK3588-SMARC — SOM выполнен по стандарту SMARC 2.1 с поддержкой всех возможностей спецификации, FFC-разъёмами для 4 камер (MIPI CSI-2), 2.5 Gigabit Ethernet с PTP и расширенным температурным диапазоном.

Идеален для промавтоматики, робототехники, медицины и систем машинного зрения.



ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ DS-RK3588-SMARC:

ПАРАМЕТР	ЗНАЧЕНИЕ	
Процессорные ядра	4 × Cortex-A76 до 2,4 ГГц 4 × Cortex-A55 до 1,8 ГГц	
ОЗУ (LPDDR4)	2 × 2 / 2 × 4 / 2 × 8 ГБ	
ПЗУ (eMMC)	32 / 128 ГБ (только для версии с ОЗУ на 16 ГБ)	
EEPROM	2 × 64 Кбайт с фиксированным MAC	
Графический процессор	Mali-G610 MP4 с поддержкой OpenGL ES 3.2, OpenCL 2.2	
Мультимедиа	Аппаратные кодеки H.265/H.264	
Нейроускоритель	До 6 TOPs, с поддержкой TensorFlow Lite, Caffe и др.	
Операционные системы	Linux BSP, Buildroot, Ubuntu	
Питание	5 В DC	
Часы реального времени (RTC)	Встроенные, с поддержкой резервного питания	
Диапазон температур	-40...+85 °C	
Габаритные размеры	82 × 50 × 5 мм	
Интерфейсы	- 2 × 2.5 Gigabit Ethernet (PHY) - PCIe 3.0 ×4 - 4 × MIPI CSI-2 (4 линии; 2 камеры на 22-контактный FFC) - 2 × LVDS, HDMI, eDP - SATA, SDIO 3.0 - 2 × USB 3.0, 4 × USB 2.0 - 4 × UART, 2 × CAN - SPI, QSPI - 13 × GPIO - 2 × I²C, 2 × I²S	
* Назначение пинов может быть изменено через Device Tree согласно документации		

DS-IMX8M — сверхкомпактный (29×29 мм) SOM под пайку на базовую плату для абсолютной вибро- и ударостойкости. Промышленный диапазон температур, Wi-Fi/Bluetooth, низкое энергопотребление, высокая производительность. GND-площадки снизу отводят тепло в базовую плату, что позволяет уменьшить габариты радиатора.

Ядро Cortex-M4 (400 МГц) с памятью TCM для задач жёсткого реального времени. Зрелая экосистема от производителя процессора: готовые решения, документация, активное сообщество.

Сферы применения: IIoT, промавтоматизация, торговое оборудование, транспорт, телематика.



ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ DS-IMX8M:

ПАРАМЕТР	ЗНАЧЕНИЕ	
Процессорные ядра	4 × Cortex®-A53 1,6ГГц + ядро Cortex-M4	
ОЗУ (LPDDR4)	512 МБ / 2 / 4 ГБ	
Flash (eMMC)	2 / 4 / 8 ГБ	
Мультимедиа	- 1080p 60 VP9 Profile 0, 2 (10-bit), HEVC/H.265 и AVC/H.264 декодер - 1080p 60 AVC/H.264 кодек	
Графический процессор	- 3D GPU (1x shader, OpenGL® ES 2.0) - 2D GPU - VPU – Video Processing Unit для работы с видеоаналитикой	
Операционные системы	Linux Ubuntu, Linux BSP, Yocto, BootLoader – U-Boot	
Разъём антенны	MHF4L (IPEX / U.FL) для антенны Wi-Fi/Bluetooth	
Питание	- 3,3...5 В DC 5 Вт	
Диапазон температур	-40...+85 °C	
Габаритные размеры	29 × 29 × 2,6 мм / 29 × 29 × 5,6 мм с радиатором	
Интерфейсы * Список интерфейсов приведён в рамках реализации в отладочном комплекте DS-IMX8M-УМИ. Назначение пинов может быть изменено через Device Tree согласно документации.	- Wi-Fi 802.11 b/g/n - Bluetooth 4.2 (BR/EDR, BLE) - PCIe 2.0 - Gigabit Ethernet (MAC) - 2 × USB 2.0 OTG	- JTAG - GPIO (1,8 В) - 3 × UART, 2 × I²C, 2 × SPI - I²C / SAI, S/PDIF TX & RX - MIPI CSI-2 / MIPI DSI (4 линии)

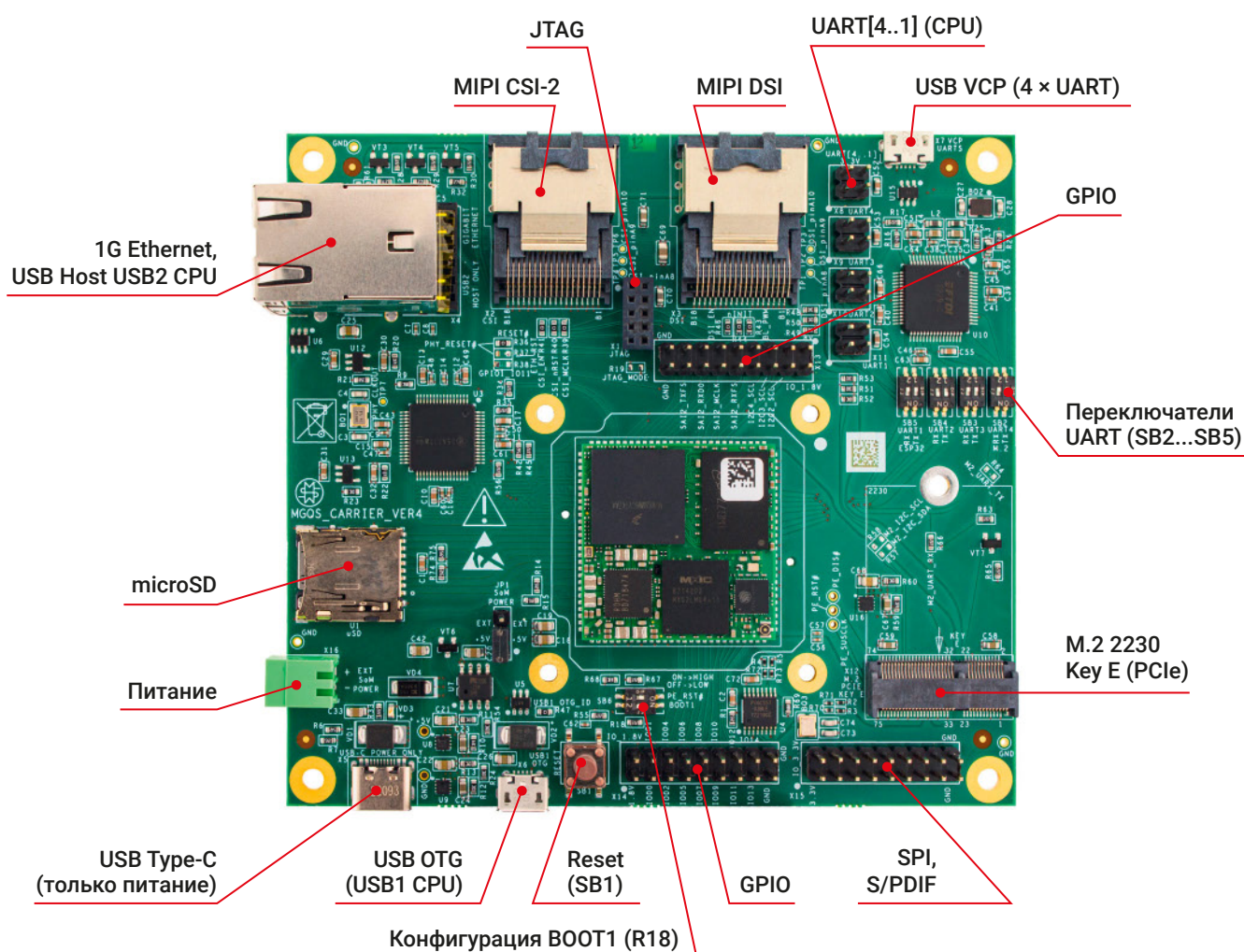
СОСТАВ ОТЛАДОЧНОГО КОМПЛЕКТА:

1. ОСНОВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ:

- Модуль DS-IMX8M-EVB (запаян на плату)

2. РЕКОМЕНДОВАННЫЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ:

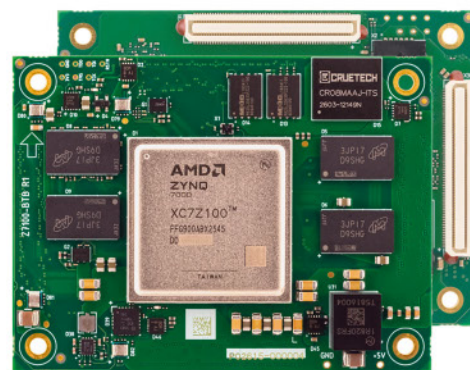
- Переходная плата MIPI DSI → HDMI
- Модуль камеры с сенсором OV5640 (OmniVision) и кабелем MiniSAS для подключения к отладочной плате



Для удобства работы с отладочным комплектом доступны репозитории со скриптами и исходниками для сборки тестового образа

DS-Z7100-BTV — высокопроизводительный процессорный модуль на гетерогенной СнК AMD (Xilinx) Zynq-7100 (XC7Z100), объединяющей 2 ядра ARM Cortex-A9 (до 800 МГц) и программируемую логику (ПЛИС) класса Kintex-7 с ~444 тыс. логических ячеек, 2020 DSP-слайсами и 16 трансиверами GTX до 12,5 Гбит/с. Через четыре 120-пиновых разъёма на базовую плату выведено 188 выводов FPGA I/O и 37 PS MIO.

Модуль предназначен для задач, где нужна производительность на аппаратном уровне при гибкости ПО: цифровая обработка сигналов, машинное зрение, SDR и телекоммуникационные протоколы, управление в реальном времени.



ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЙ:



Автомобильная
промышленность



Телекоммуникации
и сети



Промышленная
автоматизация



Обработка видео
и изображений



Медицинское
оборудование

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ DS-Z7100-BTV:

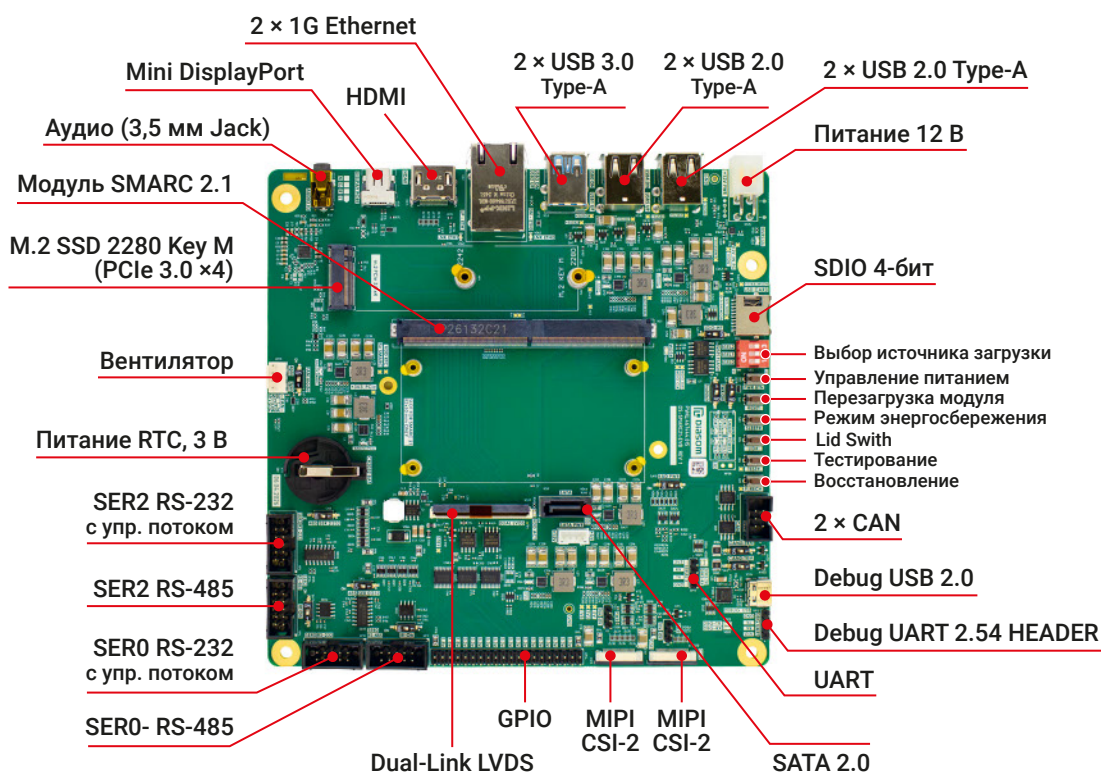
ПАРАМЕТР	ЗНАЧЕНИЕ
Процессорные ядра	2 × Cortex-A9 до 800 МГц
Программируемая логика	XC7Z100 (Zynq-7100), класс Kintex-7: ~444 тыс. логических ячеек, 2020 DSP-слайсов, 26,5 Мб BRAM
ОЗУ	1 Гб (PS) / 1 Гб (PL)
Flash (eMMC)	8 Гб
QSPI Flash	2 × 32 Мб
Операционные системы	Linux BSP, Buildroot+QT5, BootLoader - U-Boot
Средства разработки	AMD Vivado, Vitis, Vitis HLS
Питание	+5 В (однополярное питание)
Диапазон температур	-40...+85 °C
Габаритные размеры	80 × 60 × 9,5 мм
Подключение	4 × 120 пиновых разъёма
Интерфейсы	- PCIe Gen 2.0 ×8
* Назначение пинов может быть изменено через Device Tree согласно документации	- 16 × GTX (до 12,5 Гбит/с)
	- 37 × PS MIO
	- 188 × FPGA I/O

DS-SMARC21-EVB — универсальная отладочная плата для модулей SMARC 2.1 с реализацией всех интерфейсных разъёмов, предусмотренных спецификацией стандарта. Совместима с модулями DS-RK3568-SMARC, DS-RK3588-SMARC и другими модулями SMARC 2.1.

Поддерживает одновременное подключение до двух камер и трёх независимых дисплеев при соответствующей программной конфигурации. Предусмотрены разъёмы для подключения датчиков и модулей расширения, а также кнопки управления питанием и выбора источника загрузки.

ПЛАТА ВЫПУСКАЕТСЯ В ТРЁХ КОНФИГУРАЦИЯХ:

- **DS-SMARC213568-EVB_K** — с модулем DS-RK3568-SMARC
- **DS-SMARC213588-EVB_K** — с модулем DS-RK3588-SMARC
- **DS-SMARC210000-EVB_K** — без модуля



Принципиальные схемы и инструкция по быстрому запуску доступны в клиентском разделе после регистрации и авторизации пользователя.



Для удобства работы с отладочным комплектом доступны репозитории со скриптами и исходниками для сборки тестового образа

СОСТАВ ОТЛАДОЧНОГО КОМПЛЕКТА:**1. ОСНОВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ:**

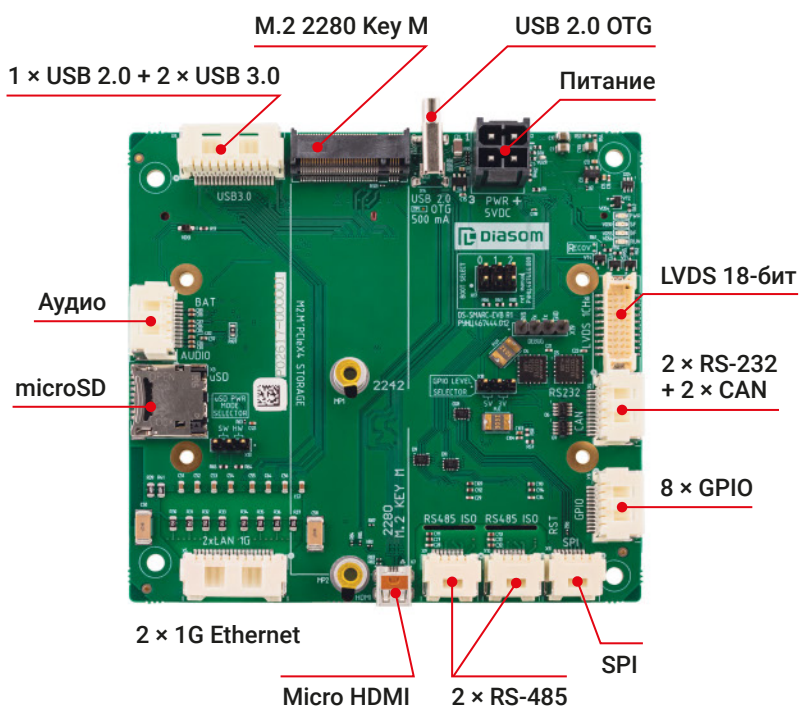
- отладочная плата DS-SMARC21-EVB
- модуль DS-RK3568-SMARC, или DS-RK3588-SMARC, или без модуля SMARC
- радиатор для охлаждения модуля
- батарейка CR2032
- карта памяти microSDHC 32 ГБ
- кабель для подключения к лабораторному источнику питания
- комплект опор для настольной установки
- винты для крепежа модуля
- термопрокладка для теплоотвода

2. РЕКОМЕНДОВАННЫЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ:

- дисплей с интерфейсом LVDS COG-TA25F325P-L5
(в комплекте: шлейфы и переходник для подключения к плате)
- модуль видекамеры DS-CIMX и дополнительно переходник для подключения с необходимыми шлейфами
- SSD NVMe SSD M.2 2280 Key M

DS-SMARC-CARRIER**ВСТРАИВАЕМАЯ БАЗОВАЯ
ПЛАТА для SMARC 2.1**

Компактный вариант встраиваемой базовой платы для любого модуля формата SMARC 2.1 в габаритах форм-фактора PC/104Plus 90,17 × 95,89 × 20,58 мм.



Предлагаемые модули камер являются основой для систем видеонаблюдения, робототехники и встроенного зрения.



КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ:

НАДЕЖНОСТЬ

Используем проверенные матрицы Sony и On Semi

УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ

Поддержка платформ RockChip (RK3588, RK3568), СКИФ/Гиперком и остальных ARM по запросу

ИНТЕГРАЦИЯ

Интерфейс MIPI CSI-2 (22 контакта, шаг 0,5 мм) совместимый с Raspberry Pi 5

КОМПАКТНОСТЬ

Малые габариты 24,5×22×5 мм без оптики

ГИБКОСТЬ

Оптика M12 (S-Mount) с вариантами комплектации

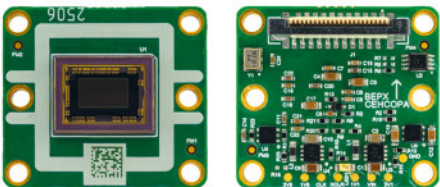
ТЕМПЕРАТУРА

Расширенный диапазон -30...+70°C

DS-CIMX327-22

НАЧАЛЬНЫЙ МЭК

Надежное решение для бюджетных проектов, которое идеально подходит для начальных систем видеонаблюдения, учебных наборов и прототипирования.

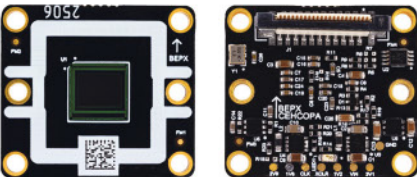


ПАРАМЕТР	ЗНАЧЕНИЕ
Разрешение	1920 × 1080 (FHD)
Размер пикселя	2,9 × 2,9 мкм
Максимальная скорость	60 кад/с
Диапазон усиления	69 дБ
Питание	3,3 В / 5 В

DS-CIMX335-22

СРЕДНИЙ МЭК

Оптимальное решение по соотношению цена/качество. Широко используется в системах помощи водителю, управлении дорожным движением и интеллектуальных системах анализа.

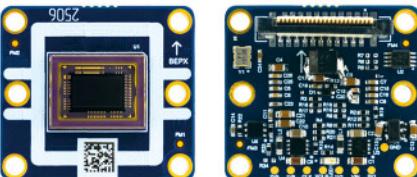


ПАРАМЕТР	ЗНАЧЕНИЕ
Разрешение	2592 × 1944 (5 Мп)
Размер пикселя	2,0 × 2,0 мкм
Максимальная скорость	60 кад/с
Диапазон усиления	12,6 дБ
Питание	3,3 В / 5 В

DS-CIMX415-22

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ МЭК

Высокое качество для критичных применений. Идеален для систем видеонаблюдения высокого уровня, автономных транспортных средств, робототехники и управления дорожным движением.

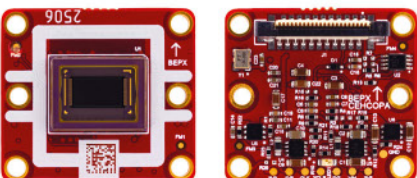


ПАРАМЕТР	ЗНАЧЕНИЕ
Разрешение	3840 × 2160 (4K)
Размер пикселя	1,45 × 1,45 мкм
Максимальная скорость	90 кад/с
Диапазон усиления	72 дБ
Питание	3,3 В

DS-CIMX662-22

ПРОМЫШЛЕННЫЙ МЭК

Максимальная частота кадров для динамичных сцен. Применяется в системах видеонаблюдения промышленных объектов, системах помощи водителю (ADAS), робототехнике и управлении дорожным движением.

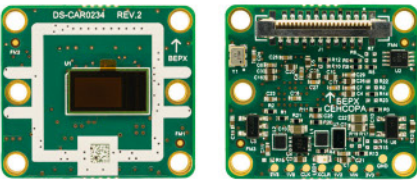


ПАРАМЕТР	ЗНАЧЕНИЕ
Разрешение	1920 × 1080 (FHD)
Размер пикселя	2,9 × 2,9 мкм
Максимальная скорость	90 кад/с
Диапазон усиления	72 дБ
Питание	3,3 В / 5 В

DS-CAR0234-22

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ МЭК

Глобальный затвор обеспечивает четкое видео для анализа быстрого движения. Применяется в системах помощи водителю (ADAS), робототехнике, БПЛА и управлении дорожным движением.



ПАРАМЕТР	ЗНАЧЕНИЕ
Разрешение	1920 × 1200 (FHD)
Размер пикселя	3 × 3 мкм
Максимальная скорость	90 кад/с
Питание	3,3 В (диапазон 2,9 – 5,3 В)

DS-CAR0233

ОЖИДАЕТСЯ В Q3 2026

Технология HDR вместе с подавлением мерцания светодиодов (LFM) обеспечивает высококачественное видео в сложных условиях освещения. Применяется в первую очередь в автомобилестроении: в системах помощи водителю (ADAS) или системах кругового обзора.



ПАРАМЕТР	ЗНАЧЕНИЕ
Разрешение	1920 × 1080 (FHD)
Размер пикселя	3 × 3 мкм
Максимальная скорость	60 кад/с
Питание	3,3 В (диапазон 2,9 – 5,3 В)

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ:

- Установка держателя оптики и фиксирующего кольца для исполнений с оптикой
- Возможность комплектования оптикой с ее калибровкой. Стандартные фокусные расстояния – 2,8 / 3,6 / 3,9 / 4 / 6 / 8 мм. Остальные по запросу.
- DS-CIMX-OPi5 - гибкий шлейф для подключения МЭК к платформе OrangePi 5
- DS-RK3568-EVB-CSI-3022_K – переходник для подключения МЭК к платформам с разъемом FFC 30 пин
- DS-ADP2 – переходник на две камеры (2 линии каждая) в один порт MIPI CSI-2 (4 линии)



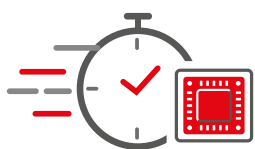
DIASOM — идеальный партнёр для создания надёжных и высокопроизводительных решений в промышленной электронике.

Предлагаем полный цикл разработки несущих/материнских плат под любые наши процессорные модули, включая:

- 1. Работа с высокоскоростными интерфейсами:** PCIe, USB 3.0, Ethernet до 10 Гбит/с
- 2. Полный цикл:** от схемотехники и макета до FCT, термоанализа и серийного производства
- 3. Эксплуатация в экстремальных условиях:** $-40...+85^{\circ}\text{C}$, вибрация, удары, высокая влажность
- 4. Сертификация:** производство по ГОСТ Р ISO 9001, ГОСТ Р 58139; продукция соответствует требованиям ТР ТС и ПП 719

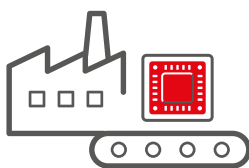
ПОМОЖЕМ ВОПЛОТИТЬ ВАШИ ИДЕИ

ПОЧЕМУ МЫ?



УСКОРЕНИЕ TIME-TO-MARKET

SOM сокращает сроки разработки, а наше глубокое знание продуктов обеспечивает быстрое создание устройств любой сложности



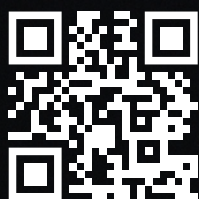
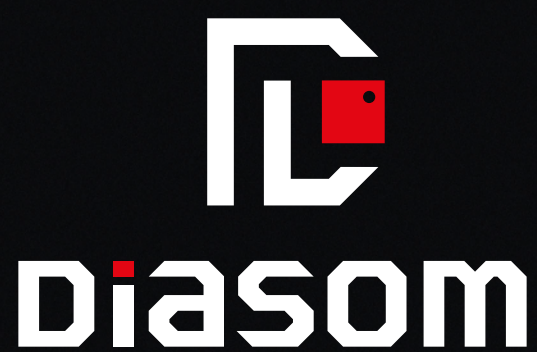
СОБСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО

От дизайна до серийного выпуска с DFM-анализом и оптимизацией комплектующих для бесперебойных закупок



НАДЁЖНОСТЬ

Создаём электронику, которая работает там, где другие отказывают. Доверьте нам ваш проект — от прототипа до серии



diasom.ru

Телефон: +7 (812) 337-12-33
Email: som@diasom.ru



t.me/diasom_Live